

公司代码：688757

公司简称：胜科纳米



**胜科纳米（苏州）股份有限公司**  
**2025年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <https://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

### 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、2025年度利润分配预案：公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.62元（含税），截至本报告披露日，公司总股本403,311,486股，以此计算合计拟派发现金红利25,005,312.13元（含税）。本次不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、2025年中期利润分配：公司已于2025年8月26日召开第二届董事会第十二次会议、于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。2025年11月公司完成了2025年中期现金红利的派发，实际派发现金红利20,165,574.30元（含税）。

综上，本年度公司现金分红合计为45,170,886.43元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为73.00%。

### 母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

### 8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1、公司简介

#### 1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	胜科纳米	688757	无

#### 1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

#### 1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周秋月	吴萍
联系地址	苏州工业园区朝前路9号	苏州工业园区朝前路9号
电话	0512-62800787	0512-62800787
传真	0512-62800007	0512-62800007
电子信箱	IR@wintech-nano.com	IR@wintech-nano.com

## 2、报告期公司主要业务简介

### 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

#### 1、主营业务基本情况

公司是行业内知名的半导体第三方检测分析实验室，主要服务于半导体客户的研发环节，可以为半导体全产业链客户提供样品失效分析、材料分析、可靠性分析等专业、高效的检测实验。半导体检测分析是半导体产业链中的重要环节，检测分析实验有助于加速客户研发进程、提升产品性能指标及良品率，在半导体技术发展、工艺演进的过程中发挥重要作用。公司通过专业精准的检测分析服务，判断客户产品设计或工艺中的缺陷，助力客户提升产品良率与性能，成为半导体领域产品研发和品质监控的关键技术支撑平台，承担辅助客户研发的重要角色。凭借多元化的检测分析项目与专业精准的诊断能力，公司可以协助客户解决产品开发、工艺改良等方面的疑难杂症，被形象地喻为“芯片全科医院”。

公司深耕半导体检测分析行业多年，检测分析实验覆盖范围广泛全面，掌握的检测分析技术应用于集成电路、分立器件、光器件、传感器、显示面板等众多领域，客户类型覆盖芯片设计、晶圆代工、封装测试、IDM、原材料、设备厂商、模组及终端应用等半导体全产业链。通过精准可靠的检测技术、全面多元的测试项目、高效及时的响应速度、有效完善的研发体系、优质丰富的客户资源以及布局合理的营销服务网络，公司在半导体检测领域形成了突出的品牌效应，目前已累计服务全球客户 2,000 余家。

## 2、主要产品或服务的基本情况

公司主要服务于客户的研发环节，公司通过各类型分析实验为客户高效地解决研发期间所面临的产品设计缺陷、工艺改良、性能提升等问题，进一步加速客户的研发进程。目前公司的检测分析实验主要包括以下类别：

类型	主要分析实验内容	主要分析实验项目类别	典型分析实验项目
失效分析	<p>主要指通过实验分析手段确定元器件既有的失效现象的原因及失效机理，或判断可能存在的失效情况；</p> <p>公司提供的失效分析实验除为探究样品失效原因的检测分析外，还包括为发现潜在失效问题、确保工艺稳定实施的破坏性物理分析（DPA）；</p> <p>针对具体的失效分析案件，公司通常根据样品特点及客户需求进行检测分析方案设计，除综合运用多类型失效分析检测项目外，还可能结合材料分析检测项目，最终为客户呈现该案件的检测分析结果</p>	无损检测分析	超高分辨率光学检测分析、超声波扫描检测分析、常规 X 射线无损检测分析、纳米 CT 无损检测分析等
		电性检测分析	电流-电压曲线特性测量、晶体管级电性参数测量、红外热成像显微检测、微光光电成像分析、红外激光故障激发失效定位分析等
		物性检测分析	样品制备包括开封制样、去层制样、研磨制样、聚焦离子束制样加工等；样品检测分析包括扫描电子显微形貌成像分析、芯片线路修改、材料分析等
材料分析	<p>主要指通过实验分析手段对样品进行材料成分及结构的分析，实现对样品的结构组织分布、元素比例构成、污染物情况等深入分析判断</p>	表面分析	X 光电子成分及价态分析、原子力表面形貌分析、飞行时间二次离子质谱分析、动态二次离子质谱分析、傅里叶有机物光谱分析等
		微区结构成分分析	透射电镜微观结构表征等
可靠性分析	<p>考察特定实验条件下产品的寿命特征、环境适应能力等，确定特定条件下产品的可靠性水平</p>	环境测试	高低温冲击试验、高加速寿命试验、高低温湿热试验、高温存储试验、高温烘烤实验等
		老化测试	高温工作寿命试验、低温工作寿命试验、高温高湿反向偏压老化试验、高温反向偏压老化试验、高温栅极偏压老化试验等
		静电测试	传输线脉冲静电测试、人体放电模式静电测试、组件充电模式静电测试等

## 2.2 主要经营模式

### 1、盈利模式及实验室多点布局模式

公司主要从事半导体第三方检测分析服务，主要服务于半导体客户的研发环节，具体包括样品失效分析、材料分析及可靠性分析等检测实验，公司通过向客户提供第三方检测分析服务实现收入和利润。公司目前在新加坡、苏州、南京、福建、深圳、青岛、北京等地多点布局实验室，多点建设实验室的业务模式是基于公司总体战略布局、重点客户服务需求，按照行业惯例做出的经营决策。

### 2、采购模式

公司主要采购分析仪器、实验耗材以及委托检测服务等。分析仪器主要为开展检测分析的专用仪器设备；实验耗材则通常包括离子源等设备配件、化学试剂、砂纸、载治具等，用于辅助完成检测分析。公司对外采购委托检测服务，主要系在出现临时性设备检测产能紧缺或面对少量超出自身检测能力范围的检测项目时委托第三方检测服务机构完成部分检测项目。

公司严格遵守《采购管理制度》等公司规章制度。采购活动一般由业务部门首先提交需求，并向采购部报送采购申请单。采购部在获取业务部门采购需求后，进行供应商准入调查，随后采购部结合市场报价确定最终供应商。经相关负责人审批后，公司按照合同管理制度，与供应商签订采购合同，并根据实际需求进行采购。

### 3、服务模式

公司主要采用以销定产的生产模式，实行订单式生产。公司根据样品情况及客户需求进行个性化的检测分析方案设计，并按照测试方案对样品进行检测，最终向客户发送检测结果报告。公司建立了多维度的生产管理制度和考核机制，重点关注测试质量与效率，并根据达成情况不断调整、优化生产过程，确保公司测试服务质量的持续提升。

### 4、销售模式

公司的销售模式为直销模式，直接面向客户提供服务。公司通过自身积累的半导体产业链先进检测技术与分析经验，以专业高效的检测分析能力为基础，实现客户营销，并深度挖掘客户各阶段的检测分析需求，为客户定制检测分析方案，随时响应客户检测需求。

公司目前已建立一支营销能力强、专业经验丰富的市场销售团队，通过直接洽谈、客户引荐、会议论坛等方式获取资源，公司客户已覆盖全国各地以及东南亚等国外地区。公司已制定《业务管理制度》，针对各客户建立基本信息表，就客户的需求变动随时进行跟进。在销售定价方面，公司销售人员以公司内部制定的各类测试服务收费标准作为参考，与客户协商确定订单价格。同时，公司综合客户付款方式、资金实力、信誉状况、合作情况等给予客户不同的信用期。

### 5、研发模式

公司建立研发部门，下设方案设计部、工艺研发部、前沿技术部以及智能数据部四个研发小组，并按照《研发管理制度》等规范要求进行研发流程管理。公司以自主研发为主，以市场需求和行业发

展趋势为导向，持续开展研发创新活动，同时将 AI 技术深度融入研发流程，以智能化手段赋能研发管理与技术创新，提升研发效率与成果质量。

基于公司业务的特点，公司研发活动具体分为立项、开展与结项阶段。在立项阶段，公司研发人员根据前期调研以及市场需求提出研发课题建议，组建项目团队并形成《研发项目立项报告》，经立项评审委员会审批通过后正式立项。在项目开展阶段，公司各研发项目负责人根据《研发项目立项报告》及《研究开发项目立项决议》确立的项目内容、范围、进度，具体开展研发活动，参与研发活动的人员根据研发项目参与情况每周对工时及机时进行填报，经研发项目负责人及研发总监两级审批后，提交财务部进行汇总核算。在结项阶段，项目负责人提交研发项目的结项报告，公司组织内部评审会议，经研发总监和公司总经理验收后，项目完成结项。

## 2.3 所处行业情况

### 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

报告期内，公司所处主要行业发展阶段、基本特点及主要技术门槛情况说明如下：

#### （1）行业发展阶段

伴随人工智能、5G 等前沿技术持续突破，半导体芯片需求持续增长，技术迭代与产品升级共同催生了新的应用场景与商业模式。半导体检测分析服务是半导体产业链中的重要环节，直接影响了芯片研发效率、产品良率和可靠性，随着半导体产业的蓬勃发展与技术升级，半导体检测分析需求持续提升，产业整体已步入高速发展阶段。

#### （2）基本特点

半导体第三方实验室检测分析具有技术领先、立场客观的特点，对于芯片设计、晶圆制造、芯片封装等过程中存在的问题，需要结合物理、化学、结构、材料等多学科知识，运用包括物性分析、电性分析、表面分析、化学分析等在内的多类型检测技术，及时地给出中立、公正的反馈，提出专业高效的建议。

公司创造性地提出了“Labless”理念，即半导体企业将失效分析等检测分析工作更多地交由专业第三方实验室执行的模式。Labless 是 Lab（实验室）与 Less（无，没有）的组合，是“无自建实验室”的运作模式，在现阶段半导体产业发展中也涵盖了“轻实验室”模式，即未购置大量检测分析实验设备而主要委托第三方进行检测，与厂内自建实验室 In-House Lab 模式相对，Labless 概念近年来已逐步受到市场认可。

与厂内自建实验室的 In-House Lab 模式相比，Labless 模式具有如下特点：

#### ① 经济性：高端检测设备的高昂成本制约厂内实验室的发展，Labless 模式可有效降低客户成本

失效分析等检测分析对设备仪器的高精度与设备品类的多元化要求较高，与 IDM 模式下制造厂商面临的高额产线投入成本问题较为类似，高端检测设备的高昂投入成本也制约了厂内实验室的发展。

一方面，高端检测设备的单台设备价值量高，厂内实验室通常无法拥有配置覆盖全方位检测需求的检测分析设备的资金实力；另一方面，厂内实验室的检测需求与自身的研发周期、调试周期息息相关，厂内实验室可能面临研发时或试生产时爆发式的检测分析需求，亦可能面临产能闲置的情况，无法达到资源的有效利用。因此，采用 Labless 模式将检测分析需求委托至第三方检测机构可有效降低客户成本。

### ② 专业性：半导体第三方实验室检测分析具备更强的专业化、多元化的检测分析技术与人才

半导体实验室检测分析需要运用电子、结构、材料、理化等多学科知识，半导体产业链总体面临人才短缺的问题，而在短时间内运用复杂技术手段对样品问题进行检测分析的综合性技术人才亦属于行业内稀缺资源。

相较于第三方实验室专家团队所具备的丰富检测案例经验、综合分析技术，厂内检测分析人才通常局限于自身半导体产业环节，如封装厂商的工程师聚焦于封装环节，对于晶圆制造工艺的技术掌握程度有限，这可能导致其在分析失效样品时无法有效判断晶圆制造环节内含的缺陷。第三方检测分析实验室则拥有产业链各环节技术人才，具备覆盖全产业链的分析能力，并通过长时间案件检测的经验积累，不断精进检测分析技术，以专业的检测分析能力与时效性赢得客户的信赖。

### ③ 中立性：独立的半导体第三方检测分析实验室提供客观、公正的建议

由于半导体产品的缺陷可能来自产业链的各个环节，除芯片设计、晶圆制造、封装测试外，上游原材料、半导体设备以及终端厂商均有可能导致产品质量问题的出现，相较于厂内自建实验室对于产品的检测分析，中立的第三方实验室可提供更为客观与公正的检测分析实验，用准确的分析结果帮助企业快速溯源失效根因，为客户的产品设计及制造工艺优化提出解决建议。

## (3) 主要技术门槛

### ① 技术壁垒

半导体检测分析机构掌握的各类检测技术是开展检测分析的基础。随着国内半导体和集成电路产业的发展，尤其是近年来汽车智能化、网联化、电动化等趋势的快速发展，对半导体产品的安全性、可靠性要求愈加严苛，半导体制造过程的低容错率也对检测分析提出了更高的要求。

公司已深度掌握各类型检测理论与操作技术，可根据样品的失效情况与检测需求选择适当的检测分析项目，高效精准地实现客户的特定检测需求，同时，公司掌握针对各类型案件进行定制化检测分析方案设计的能力。此外，由于失效样品数量极少，为避免引入新的缺陷结果造成失效分析失真，在检测分析过程中公司掌握的样品制备能力也显得至关重要。

行业新进入者往往很难在短时间内形成有竞争力的检测技术，这使得行业具有较高的技术门槛，对潜在的市场进入者构成了壁垒。

### ② 人才壁垒

半导体第三方检测方案的设计涉及样品制备、成像分析、失效分析、材料表征、可靠性分析、整合方案等多个专业领域，需要专业技术人员拥有包括电子、结构、材料、理化在内的多方面理论知识与实践技术储备。

具体就公司业务开展对专业技术人员的要求而言，研发人员通常为综合能力强的较高学历人才，在掌握半导体检测分析实践经验的基础上，需了解半导体产业链各环节的相关工艺技术，同时需具备快速学习与行业前瞻分析能力，及时跟进半导体产业技术迭代与发展，并对未来行业所需检测分析技术进行前沿调研及分析。公司拥有的生产技术人员同样需具备相应的半导体检测分析理论知识及学历门槛，在了解理论知识的基础上，通过实践培训掌握检测分析技术，实现高效精准的上机操作。因此，半导体检测分析对技术人员的实践操作能力要求较高，需要通过一定时间的积累或密集高效的专业培训来掌握专业技术。

目前，国内半导体检测行业的整体技术水平与发达国家还存在一定差距，行业内高素质人才相对短缺且高端人才培养很难在短期内快速实现，技术人员也需要一定时间的经验积累或借助行业内成熟企业内部高效的培训积累经验，这对新进入企业构成了一定的专业人才壁垒。

### ③ 客户认证壁垒

对于新进入者而言，快速获取稳定的客户资源是进入该行业的主要壁垒之一。检测业务对服务提供方的保密性、服务质量、服务效率等方面要求较高。半导体检测行业主要客户群体涵盖国内外一线龙头，在第三方测试服务商选择时通常需要进行严格的资质验证，合作前对供应商的生产能力、产品工艺、质量、技术水平等进行充分考核。由于更换服务提供方需面临较大的质量控制风险并承担时间成本，因此客户倾向于与检测机构形成长期、稳定的合作关系。市场新入者需要更大的投入才能成功创立新的品牌和突破市场已有的品牌壁垒，且很难在短时间内建立忠诚度。

### ④ 资质认证壁垒

公司从事半导体第三方检测分析实验，由于检测分析数据将对下游客户的研发试制、产品性能、生产效率等带来重要影响，因此从事第三方检测分析的实验室通常需要获得权威认证机构颁发的资质，以获得下游客户的信赖和认可。同时，在合作过程中客户亦通常要求企业具备一定的相关资质，如满足 CNAS 实验室认可和 CMA 资质认定证书等。CNAS 实验室认可和 CMA 资质认定证书等相关资质需要检测机构具备一定时期的检测业务经验、认证要求较高，对新进入检测行业的企业形成一定的资质壁垒。

### ⑤ 资金壁垒

半导体检测行业对资本规模和资金实力有较高需求。半导体检测服务之过程主要是依赖不同功能的分析设备执行精细的分析作业。由于半导体制程精密，产品功能复杂，行业需要密集资本投入促进检测设备更新换代。另一方面，由于半导体行业技术更新较快，检测分析技术研发的时间周期长，企业为了保持技术的与时俱进，需要持续进行高额的研发投入，以满足下游的更新换代需求，为行业构筑了一定的资金壁垒。

## 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司创造性地提出了“Labless”理念，Labless 是 Lab（实验室）与 Less（无，没有）的组合，是“无自建实验室”的运作模式，在现阶段半导体产业发展中也涵盖了“轻实验室”模式（Lab-Lite），即

无需购置大量检测分析实验设备而主要委托第三方进行检测，与厂内自建实验室 In-House Lab 模式相对。Labless 模式下的半导体第三方检测机构可以解决厂内实验室建立及维护成本高、分析技术迭代受阻、专业人才流失等问题，具有经济性、专业性、时效性等特点，近年来逐步被市场认可。公司围绕“Labless”理念，凭借多元化的检测分析项目与专业精准的诊断能力，为半导体设计、材料、制造、封测、设备厂商等提供第三方检测分析服务。

从业务体量上看，公司在半导体第三方检测分析市场的业务体量已处于国内前列，具备行业内较为领先的市场地位。2025年，公司实现主营业务收入 52,850.54 万元，其中境内主营业务销售规模为 46,689.26 万元，业务规模在同行业中较为靠前，尤其是在技术难度更高的失效分析、材料分析领域，公司占据更高的市场份额。根据 QY Research 的估算，2025 年我国半导体第三方检测分析领域失效分析及材料分析市场规模合计约为 54.93 亿元，公司 2025 年度在失效分析及材料分析领域的国内收入合计达到 4.54 亿元，国内市场占有率约为 8.26%，失效分析和材料分析业务份额相对较高。

从技术实力上看，公司长期聚焦前沿检测分析技术，持续推进重点研发项目的技术攻坚，不断拓宽检测分析服务品类与应用场景，目前公司的检测分析技术在行业内处于相对领先水平。公司在检测分析技术、测试样品制备、测试治具改造等方面已经形成了 20 余项核心技术，拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的 90 余项检测项目、检验检测机构资质认定（CMA）认可的 30 余项检测项目，在同行业内获认可的项目数量相对靠前，特别是在失效分析、材料分析领域相对领先。公司分析实验更多地聚焦先进工艺，其中对先进制程的覆盖能力可以达到 3nm，处于行业前列。同时，公司紧跟人工智能技术发展趋势，积极推动现有检测分析业务与 AI 技术的数智化融合，以构筑行业技术壁垒，不断提升公司综合竞争力。凭借行业内领先的检测分析技术，公司已累计服务全球 2,000 余家客户，其中包括众多半导体产业链龙头企业，随着公司的检测服务能力逐步获得客户的广泛认可，市场地位持续提升，公司已发展成为我国最具影响力的第三方半导体检测分析实验室之一。

### 3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司所处半导体第三方检测分析行业的发展与半导体行业整体的景气度相关性较高，近年来得益于人工智能、高性能计算、汽车电子和工业数字化的快速发展，全球半导体行业景气度不断上升。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2025 年全球半导体产业收入规模达 7,956.4 亿美元，较上年同比增长 26.2%，增长主要得益于逻辑芯片、存储芯片、传感器等领域的强劲需求。在半导体行业快速发展的背景下，半导体企业对产品性能和生产良率的提升有更高要求，进而加速了产品研发与工艺升级的进程，研发阶段的新产品设计与新工艺研究、新产品检测与新产线调试等环节，催生出大量的检测分析需求。

半导体检测分析服务覆盖半导体全产业链，包括芯片设计、晶圆制造、封装测试、IDM、原材料、设备厂商、模组及终端应用等各环节。在芯片设计领域，随着 AI 产业热潮的推动、半导体国产化进程的深化，包括 CPU、GPU 在内的逻辑芯片以及存储芯片等将迎来快速发展，芯片设计企业将保持高强度的研发投入，相应的检测分析需求也将不断提升。在晶圆制造领域，随着工艺制程由 28nm 以上的成熟制程向 28nm 以下的先进制程转变，甚至向 7nm 及以下工艺节点发展，相关分析需求将持续增长。

在封装测试领域，先进封装将成为延续摩尔定律的重要途径，各类型先进封装形式的发展将带动分析需求的增长。随着半导体产业的持续发展和技术升级，第三方检测分析服务的市场需求将持续增长，市场前景广阔。

同时，随着国家“人工智能+”行动的深入实施，人工智能、大数据、物联网、云计算等前沿技术正在与各行业深度融合，尤其在半导体检测分析领域，面对日趋海量、高维、非结构化的数据挑战，传统依靠人员经验的检测方法，已经难以适应半导体产业快速升级需求，AI算法与半导体检测分析的深度融合已成为行业发展的必然趋势。在此背景下，公司将积极顺应半导体产业技术趋势与国家“人工智能+”战略布局，进一步拓展AI技术在半导体检测分析领域的应用，助力公司实现业务模式的升级，进一步提升检测分析效率，促进公司健康持续发展。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	1,972,917,736.25	1,492,105,289.02	32.22	1,207,229,253.71
归属于上市公司股东的净资产	888,042,708.96	605,965,950.39	46.55	521,680,829.76
营业收入	529,527,268.32	415,271,937.75	27.51	393,983,281.92
利润总额	62,431,997.61	89,688,692.45	-30.39	110,456,050.46
归属于上市公司股东的净利润	61,878,956.38	81,181,245.55	-23.78	98,538,519.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,171,086.77	72,516,697.83	-22.54	85,879,055.22
经营活动产生的现金流量净额	202,988,732.05	221,436,399.20	-8.33	238,640,094.17
加权平均净资产收益率(%)	7.49	14.40	减少6.91个百分点	20.58
基本每股收益(元/股)	0.16	0.22	-27.27	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.22	-27.27	0.27
研发投入占营业收入的比例(%)	10.83	11.03	减少0.20个百分点	10.80

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)

营业收入	108,548,186.51	130,691,980.30	146,604,936.43	143,682,165.08
归属于上市公司股东的净利润	11,519,012.52	21,849,627.67	23,218,225.61	5,292,090.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,315,044.87	20,208,946.12	22,043,117.39	2,603,978.39
经营活动产生的现金流量净额	39,409,503.89	47,711,539.45	68,693,115.71	47,174,573.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4、 股东情况

##### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)		7,365					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		7,249					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）							
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
李晓旻	0	158,937,232	39.41	158,937,232	无	0	境内自然人
宁波丰年荣通投资管理 有限公司—宁波梅 山保税港区丰年君和 创业投资合伙企业 （有限合伙）	0	25,071,347	6.22	25,071,347	无	0	其他
江苏鸾翔技术咨询有 限公司	0	24,266,840	6.02	24,266,840	无	0	境内非国有 法人
深圳市高捷金台创业 投资管理有限公司— 深圳市高捷智慧股权 投资基金合伙企业 （有限合伙）	0	23,884,070	5.92	23,884,070	无	0	其他

苏州禾芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	20,052,382	4.97	20,052,382	无	0	其他
苏州纳川投资管理有限公司—苏州工业园区苏纳同合纳米技术应用产业基金合伙企业（有限合伙）	0	17,487,321	4.34	17,487,321	无	0	其他
苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业（普通合伙）—苏州永鑫融畅创业投资合伙企业（有限合伙）	0	11,069,267	2.74	11,069,267	无	0	其他
付清太	0	9,352,585	2.32	9,352,585	无	0	境内自然人
天津泰达恒鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	0	7,444,877	1.85	7,444,877	无	0	其他
苏州德开元泰投资管理有限公司	0	7,442,679	1.85	7,442,679	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	李晓旻与江苏鸢翔技术咨询有限公司及苏州禾芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

**存托凭证持有人情况**

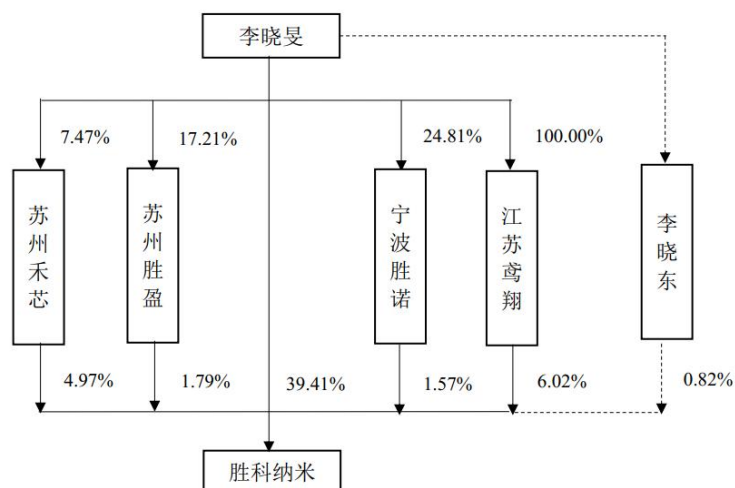
适用 不适用

**截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

适用 不适用

**4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

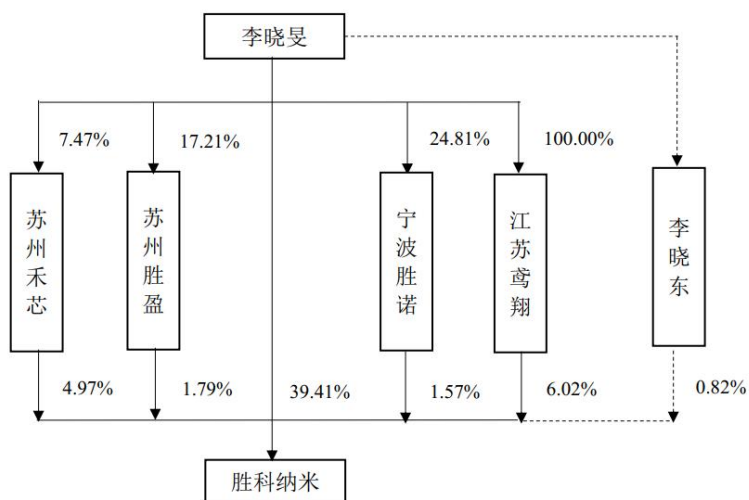
适用 不适用



注：实际控制人李晓旻与其一致行动人苏州禾芯、苏州胜盈、宁波胜诺、江苏鸢翔以及李晓东，合计持股比例为 54.57%。

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：实际控制人李晓旻与其一致行动人苏州禾芯、苏州胜盈、宁波胜诺、江苏鸢翔以及李晓东，合计持股比例为 54.57%。

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5、公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 52,952.73 万元，较上年同期增长 27.51 %；归属于上市公司股东的净利润为 6,187.90 万元，较上年同期下降 23.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,617.11 元，较上年同期下降 22.54%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用